



本社：〒160-8366
東京都新宿区西新宿 6 丁目 24 番 1 号
西新宿三井ビルディング

報告書番号：PCN#20080814002
2008 年 8 月 27 日

お客様各位

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社
営業・技術本部 ビジネスオペレーションズ部
カスタマドキュメント マネージャ 牧 達郎 (牧)

SOIC 8/14Dパッケージ一部製品 組立サイト追加変更のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄の事とお喜び申し上げます。平素は弊社製品のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、標題の件につきまして下記にご連絡させていただきます。ご査収の程、宜しくお願い申し上げます。

敬具

－ 記 －

通知タイプ	☐ Initial notice (Plan)	☒ Final notice
変更概要	Design/Specification	☐ Design ☐ Electrical ☐ Mechanical
	Wafer Fab	☐ Site ☐ Process ☐ Material
	Wafer Bump	☐ Site ☐ Process ☐ Material
	☒ Assembly	☒ Site ☐ Process ☒ Material
	Test	☐ Site ☐ Process
	Others	☐ Packing/Shipping/Labeling ☐ -
変更内容	SOIC 8/14D パッケージ一部製品 組立サイト追加変更 現行：TI-Taiwan 変更後：TI-Taiwan 及び TI-Mexico	
対象製品	対象製品リスト参照	
変更時期	2008 年 12 月上旬の出荷より予定しています。 (サンプルは、10 月上旬を予定しています。)	
品質認定試験	☐ 計画	☒ 終了
製品表示	☐ 変更無し	☒ 変更あり
備考	－	

尚、変更時期につきましては、在庫状況により異なりますので、担当営業にお問い合わせ下さい。
また、ご不明な点、ご質問等がございましたら、担当営業或いはpcn_tij@list.ti.comにお問い合わせ下さい。

以上

変更内容

内容：弊社 HPA(ハイパフォーマンスアナログ) SOIC 8/14Dパッケージ一部について、現行TI-Taiwanにて製造していますが、これに加えTI-Mexicoサイトでの製造を追加し認定しました。この変更に伴い、いずれも既に量産に適用しているものになりますが、下記部材の使用とさせていただきます。尚、出荷梱包部材につきましては、追加認定したサイトで現在使用しております部材の使用とさせていただきます。今回の変更で、製品についての互換性(寸法/公差)、外観、動作特性、品質、信頼性への影響はありません。

変更内容

組立製造サイト

マウントコンパウンド

現行

TI-Taiwan

Hitachi EN4088Z

変更後

TI-Taiwan、TI-Mexico

Hitachi EN4088Z、QMI 505MT

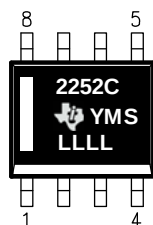
理由：製品安定供給確保の為

対象製品リスト

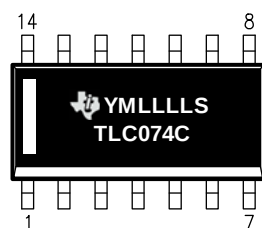
対象製品名				
TLC074CDR	TLC277CDR	TLC374CDR	TLE2037IDR	TLV2252IDR
TLC074CDRG4	TLC277CDRG4	TLC374CDRG4	TLE2037IDRG4	TLV2252IDRG4
TLC2252CDR	TLC27L4ACDR	TLC393IDR	TLE2062AIDR	TLV2462CDR
TLC2252CDRG4	TLC27L4ACDRG4	TLC393IDRG4	TLE2062AIDRG4	TLV2462CDRG4
TLC2254ID	TLC27L4CDR	TLC556CDR	TLE2072ID	
TLC2254IDG4	TLC27L4CDRG4	TLC556CDRG4	TLE2072IDG4	
TLC274CDR	TLC339IDR	TLE2027IDR	TLE2142IDR	
TLC274CDRG4	TLC339IDRG4	TLE2027IDRG4	TLE2142IDRG4	

製品表示

製品捺印にて、サイトコード“S”の記載が“T”(TI-Taiwan)に加え、“M”(TI-Mexico)となります。図-1を例としてご参照ください。



YM = Year/Month Code
 LLLL = Assy Lot
 S = Site Code
 T : TAI (TI-Taiwan)
 M : FMX (TI-Mexico)
 | = Pin 1 Stripe



YM = Year/Month Code
 LLLL = Assy Lot
 S = Site Code
 T : TAI (TI-Taiwan)
 M : FMX (TI-Mexico)
 | = Pin 1 Stripe

図-1. 製品捺印の表示例

信頼性試験

信頼性試験結果

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	-	終了	2008 年 6 月 23 日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qualification Device:	TLC274CDR		TLV2462CD	
Die Rev/ Size(mils):	F / 109.0 X 69.0		A / 49.0 X 49.0	
Wafer Fab Site:	DFAB		DFAB	
Technology/ Fab Process:	CMOS / LinCMOS_5/5		BiCMOS / LBC3S	
Assembly Site:	FMX		FMX	
Package/ Pin Count:	D / 14		D / 8	
Mold Compound:	LOC GR825-73B		LOC GR825-73B	
Mount Compound:	QMI 505MT		QMI 505MT	
Bond:	TS-0.95Au		TS-0.95Au	
L/F Composition/ Finish:	Cu / NiPdAu		Cu / NiPdAu	
MSL:	LEVEL1-260C		LEVEL1-260C	
Flammability Rating:	UL 94 V 0		UL 94 V 0	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	TLC274CDR	TLV2462CD	
		Sample Size/ Fails	Sample Size/ Fails	
Manufacturability	Per site spec	Approved	Approved	

信頼性試験結果

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	-	終了	2004 年 6 月 15 日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qualification Device:		SN74HC4060D	TL598CD	
Die Rev/ Size(mils):		G / -	F / 80.0 x 80.0	
Wafer Fab Site:		SHE	SHE	
Technology/ Fab Process:		CMOS / HCMOS	Bipolar / JI Bipolar	
Metal1-2:		TiW/AICu2%	TiW/AICu2%	
Passivation:		10KACN	10KACN	
Assembly Site:		FMX	FMX	
Package/ Pin Count:		D / 16	D / 16	
Mold Compound:		LOC GR825-73B	LOC GR825-73B	
Mount Compound:		QMI 505MT	QMI 505MT	
Bond:		TS-0.95Au	TS-0.95Au	
L/F Composition/ Finish:		Cu / NiPdAu	Cu / NiPdAu	
MSL:		LEVEL1-260C	LEVEL2-260C	
Flammability Rating:		UL 94 V 0	UL 94 V 0	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	SN74HC4060D	TL598CD	
		Sample Size/ Fails	Sample Size/ Fails	
** Steady-state Life Test	150C, 300 hrs	120/0	120/0	
** Biased HAST	130C/85%RH, 96 hrs	78/0	78/0	
** Autoclave	121C, 96 hrs	231/0	231/0	
** Temperature Cycle	-65/150, 1000 cyc	231/0	231/0	
** Thermal Shock	-65/150, 1000 cyc	231/0	231/0	
** Storage Bake	170C, 420 hrs	231/0	231/0	
Lead Pull to Destruction	Per MFG spec	66/0	66/0	
Flammability	UL 94V-0	15/0	15/0	
	UL-1694	15/0	15/0	
	IEC 695-2-2	15/0	15/0	
X-RAY	Top side, per mfg spec	15/0	15/0	
Moisture Sensitivity	Level 1/260C	12/0	12/0	
** Preconditioning at Jedec 1, 260C				